



LIPAC

Packaging Light for Interconnect

**(주)라이팩은 광연결에 사용되는 핵심 부품인
광엔진을 전문적으로 개발/생산/판매하는 기업입니다**

전세계적으로 디지털 데이터의 양이
폭발적으로 증가하고 있는 4차 산업혁명 시대에,
우리의 고민은 오직 하나입니다

“어떻게 하면 디지털 데이터를 좀 더 빠르고 정확하게 전달할 수 있을까?”

그래서 우리는 빛을 이용해
디지털 데이터를 전달하는 광연결에 대해
매일같이 고민하고 연구합니다



기업 개요



* 기업명인 Lipac은 Light Packaging의 줄임말로, Advanced Semiconductor Packaging 기술에 기반하여 광연결 산업에서 가지고 있는 근본적인 기술적 문제들을 해결하고자 하는 (주)라이팩의 의지와 열정을 표현하는 말입니다.

기업명	주식회사 라이팩 (Lipac Co., Ltd.)
대표이사	박동우
설립일	2019년 11월 19일
주력제품	광연결용 광엔진
주요사업	광엔진 개발/생산/판매 및 지원 서비스
자본금	663,020,000원
사업자등록번호	475-87-01316
주소	서울특별시 영등포구 선유로9길 10 문래 SK V1 센터 916호
홈페이지	www.lipac.co.kr

기업 구성



대한민국 서울 본사

- 주소: 서울특별시 영등포구 선유로9길 10 문래 SK V1 센터 916호
- 대표이사: 박동우
- 직원수 : 14 명
- 주요 역할 : 광엔진 개발/생산/판매/서비스

대만 타이페이 연락사무소

- 주소: 설립 중
- 소장 : Uchida, Toshikazu
- 직원수 : 3 명
- 주요 역할 : 광엔진 부품 개발/생산/외주관리/영업

리더십



박동우 (Park, David Dongwoo), 대표이사

학력: 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 수료

- 2018 ~ 현재 : (주)지파랑, CEO
- 2016 ~ 2017 : Kern Thoroughbreds, LLC., USA, CTO
- 2009 ~ 2010 : (주)이미지넥스트 선임연구원
- 2006 ~ 2009 : LG전자(주) 주임연구원



박영준 (Park, Young June), 사내이사

학력: 미국 메사추세츠대학교 전자공학과 박사

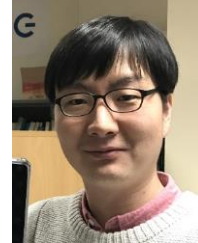
- 2018 ~ 현재 : SK하이닉스(주) 기술고문 위원
- 2018 ~ 현재 : 삼성전자(주) 리미트 돌파 산학협력과제 단장
- 1988 ~ 2018 : 서울대학교 전기정보공학부 교수
- 2000 ~ 2018 : SK하이닉스(주) 사외이사
- 1983 ~ 1988 : 미국 IBM / 금성반도체(주) 책임연구원



고병천 (Koh, Byeong Cheon), 사외이사

학력: 미국 미시건대학교 응용역학과 박사

- 2012 ~ 현재 : (주)옵티시스 기술고문
- 2006 ~ 2012 : 삼성전자(주) 부사장 (CTO)
- 2003 ~ 2006 : 삼성전자(주) 종합기술원 전무이사
- 2000 ~ 2003 : 삼성전자(주) 중앙연구소 상무이사
- 1995 ~ 2000 : 삼성전자(주) 기반기술센터, 이사



최성욱 (Choi, Seungwook), CTO

학력: 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사

- 2017 ~ 현재 : (주)지파랑, CTO
- 2013 ~ 현재 : 대한민국 산업자원부 CISS 사업단 PM
- 2013 ~ 2017 : 서울대학교 창의정보인재사업단 박사후 연구원
- 2013 ~ 2013 : 서울대학교 나노시스템연구센터 박사후 연구원
- 2012 ~ 2013 : BK21 연구단, 박사후 연구원



Uchida, Toshikazu, 개발팀 팀장

학력: 일본 Tokyo Institute of Technology 정보공학과 박사

- 2017 ~ 2019 : Eleocom Inc. (Taiwan), Vice President
- 2012 ~ 2015 : Fibest Limited. (Japan), R&D Director
- 2010 ~ 2011 : PCL Technologies (China), Vice President
- 2003 ~ 2010 : Inteleo Corp. (Japan), CEO
- 1984 ~ 2003 : AT&T Bell Lab., TIT, HP Lab., etc.

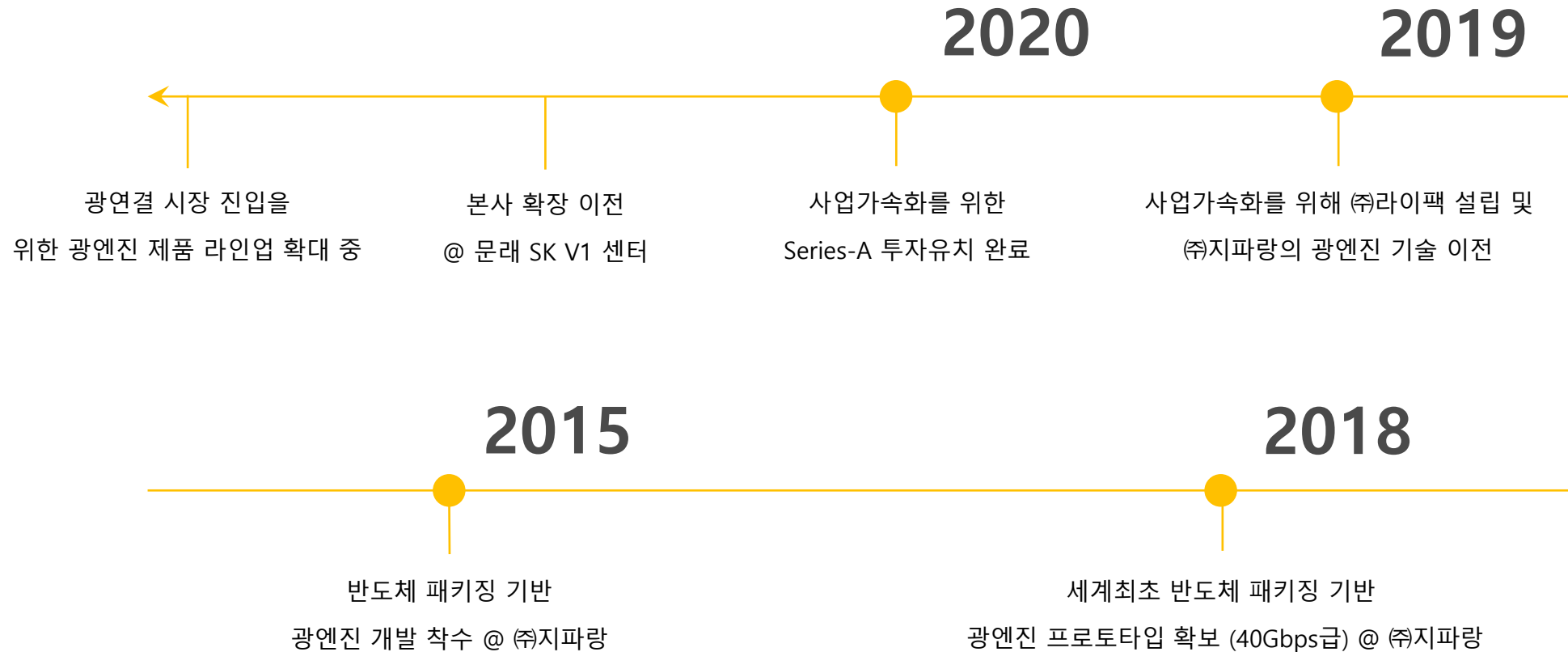


한승만 (Han, Seung Man), 품질관리팀 팀장

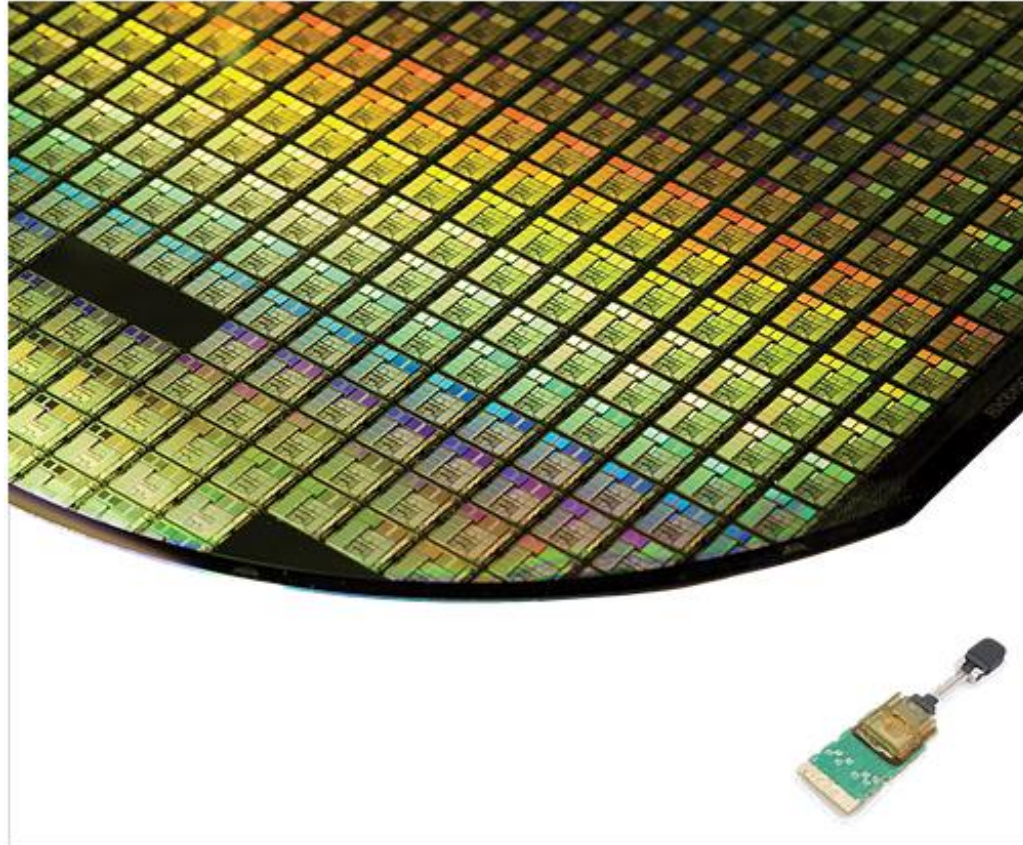
학력: 충북대학교 물리학과 석사

- 2017 ~ 2018 : (주)루멘스, AOC/HUD팀, 팀장
- 2015 ~ 2017 : OPTIS, 필리핀 OPI 공장, 부장
- 2004 ~ 2015 : 도시바 삼성 스토리지 테크, 수석연구원
- 2000 ~ 2004 : 삼성전자 ODD 사업부, 책임연구원
- 1996 ~ 2000 : LG전자 광소자 사업부, 선임연구원

연혁



핵심 기술



(주)라이팩의 SOSA 기술이란?

SOSA란 SiP-based Optical Sub Assembly의 약자로, 발전된 반도체 패키징 기술 (Advanced Semiconductor Packaging)에 기반하여 광엔진을 제작하는 플랫폼 기술을 의미합니다

(주)라이팩의 SOSA 기술은

광엔진 내부에 포함되는 Laser, Driver IC, AWG 등 주요 부품들간의 정밀한 정렬이 가능하도록 하여 크기, 원가, 양산성, 고속대응성에서 월등한 개선을 가능하게 합니다.



소형화



원가 절감



양산성 증가



고속대응성 향상

제품 라인업 - 광연결용 광엔진

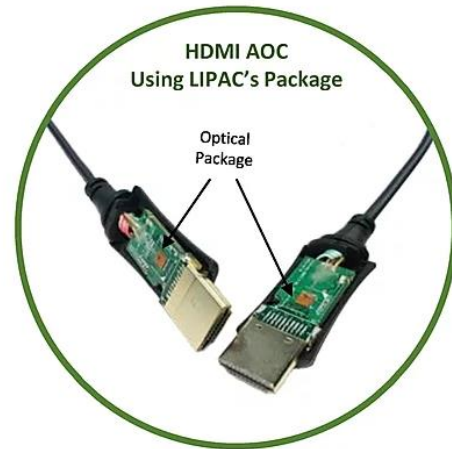
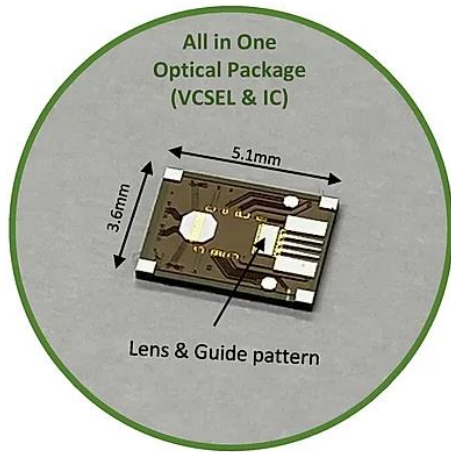
(주)라이팩은 2021년 첫 시장진입을 목표로 합니다

(주)라이팩은 데이터센터에서 사용되는 다양한 규격의 Server-to-Server 광엔진 제품을 현재 개발 중에 있습니다.

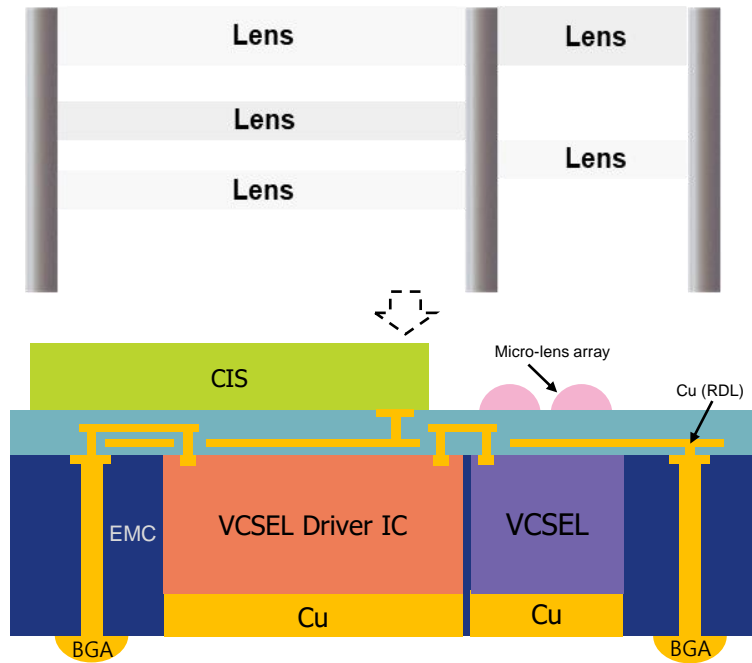
(주)라이팩의 첫 제품들은 High-end 급의 광엔진들로서 사이즈, 가격, 양산성, 고속대응성 측면에서 강력한 경쟁력을 가질 것입니다

개발중인 광연결용 광엔진 규격

- 100G-SR4
- 100G-CWDM
- 100G-LR4
- 400G-SR8



제품 라인업 - IoT 센서용 광엔진



(주)라이팩은 IoT 센서용 광엔진으로도 제품군을 확장 중입니다

(주)라이팩의 SOSA 기술은 IoT 센서용 광엔진을 제작하는데에도 최적화된 방법을 제공합니다.

(주)라이팩의 SOSA 기술로 제작되는 광엔진은 초소형화될 수 있을 뿐 아니라 대량 생산이 가능하기 때문에 모바일용 ToF 센서, TWS (True Wireless Stereo)용 근접센서에 강력한 경쟁력을 가질 수 있습니다.

개발중인 IoT 센서용 광엔진 규격

- 모바일용 ToF 센서 광엔진
- TWS용 광엔진

기술 경쟁력



**SOSA 기술의 진정한 경쟁력은
광연결 적용이 가능한 분야를 확대하는데 있습니다**

광엔진 제작에 사용되던 기존의 CoB (Chip on Board)기술은
서버와 서버를 연결하는 광트랜시버용 광엔진을 제작하는데 급급합니다

(주)라이팩의 SOSA 기술은

400Gbps / 800Gbps 급 이상의 서버와 서버 연결 뿐 아니라
보드와 보드, 칩과 칩 연결까지 광연결이 가능하도록 합니다



LIPAC

Packaging Light for Interconnect

www.lipac.co.kr

info@lipac.co.kr

서울특별시 영등포구 선유로 9길 10 문래 SK V1 센터 916호